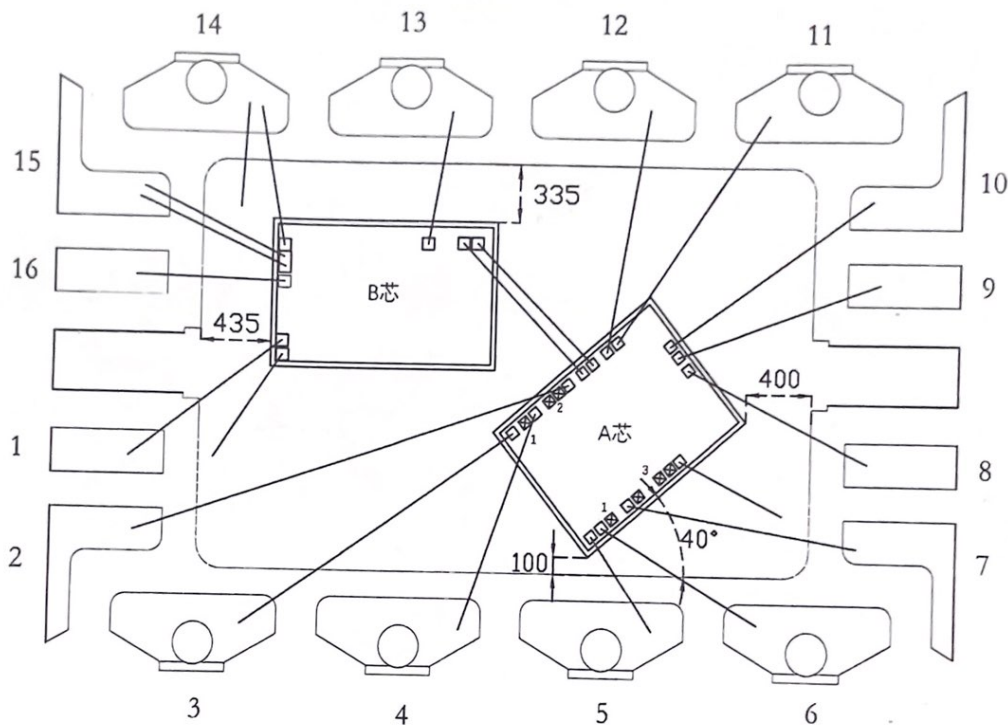
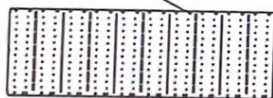


 池州华宇电子科技股份有限公司 CHIZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 焊线图纸 Bonding Diagram				客户代码 Customer No.	008	线号 Drawing No.	HY-PX-008-742 A	
产品名称 Product Type				HS24G3612		封装类型 PKG Type	SOP16L(12R)	
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线数量 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长焊线长(μm) Longest wire length	最短焊线长(μm) Shortest wire length	塑料料型号(绿色环保) Compound Type (Green)	LF 载体尺寸 LF Pad Size	
合金丝 Ag	20	22	31244	2834	668	优选(Preferred): CEIL-1702J1P 参选(Optional): EMH-G630AY	SOP16L-12R (34*150mil) 2300*3810um ²	
客户图号 Customer drawing NO.								



板电特延方向 (装片):
L/F Direction (D/A):

椭圆孔



实物图:
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

DB注意:
1. 以随工单要求按顺序装片, 如: 先装A芯片, 装B芯片时必须装在有A芯片的框架, 反之先装B芯片, 装A芯片时B芯已经装片;
2. 控制溢胶, 为WB预留焊线位置;
WB注意:
1. 数字为不打线pad点个数;
2. 植球点在B芯

说明 Instruction	贴片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPP(μm ²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	焊盘厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	贴片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否足 Low-R (1/2/3/4/5)	减薄厚度 (μm) R.d. Thickness
A芯: DIE A	导电胶 (conductivity) S210	HS5137	1200*890(μm ²) 47.24*35.04(mil) ²	60*60	82	0.8	是/Yes	60	8	否/NO	300
B芯: DIE B	导电胶 (conductivity) S210	NTU003A	1342*804(μm ²) 52.84*31.65(mil) ²	60*60	87	2	是/Yes	60	8	否/NO	300
C芯: DIE C											
编制 Prepared by	刘杰 2024.3.15		制图日期 Create Date	2024/3/15		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature				
研发审核 R&D Check	刘杰 2024.3.15		产品工程审核 PE Check			批准 Approved by	刘婧婧 2024.03.18				

*温馨提示: 图纸为产品下线的唯一依据, 请您认真确认, 我司依据您回签的图纸生产, 如因图纸错误产生不可估量损失, 谢谢!
*Warm tips: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce incalculable loss. Thank you!

页码 Page:

1 / 1